

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年12月11日
【会社名】	株式会社メイコー
【英訳名】	Meiko Electronics Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 名 屋 佑一郎
【本店の所在の場所】	神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号
【電話番号】	0467-76-6001 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理室長 古 屋 督 生
【最寄りの連絡場所】	神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号
【電話番号】	0467-76-6001 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部 部長 丸 山 秀 隆
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 607,872,000円 (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年12月3日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が平成25年12月11日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

- 1 新規発行株式
- 2 株式募集の方法及び条件
 - (1) 募集の方法
 - (2) 募集の条件
- 4 新規発行による手取金の使途
 - (1) 新規発行による手取金の額
 - (2) 手取金の使途

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

(訂正前)

<前略>

(注)2 本募集とは別に、平成25年12月3日(火)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式6,440,000株の一般募集(以下「一般募集」という。)を予定しておりますが、その需要状況を勘案し、960,000株を上限として、一般募集の主幹事会社であるSMB C日興証券株式会社が当社株主である名屋佑一郎(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社は、SMB C日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)を上限に、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)を行使期限として付与します。

SMB C日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日からグリーンシューオプションの行使期限までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、上限株式数の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMB C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<中略>

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、平成25年12月11日(水)から平成25年12月16日(月)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMB C日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMB C日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われませ
ん。

<後略>

(訂正後)

<前略>

(注)2 本募集とは別に、平成25年12月3日(火)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式6,440,000株の一般募集(以下「一般募集」という。)を行いますが、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が当社株主である名屋佑一郎(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式960,000株(以下「借入株式」という。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。

本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、S M B C日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であり、当社は、S M B C日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)を上限に、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成26年1月10日(金)を行使期限として付与します。

S M B C日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、平成25年12月14日(土)から平成26年1月10日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、上限株式数の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、S M B C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<中略>

(削除)

<後略>

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	960,000株	812,591,000	406,295,500
一般募集			
計(総発行株式)	960,000株	812,591,000	406,295,500

(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連してS M B C日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	S M B C日興証券株式会社
割当株数	960,000株
払込金額	812,591,000円

< 中略 >

- 4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
- 5 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成25年11月22日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	960,000株	607,872,000	303,936,000
一般募集			
計(総発行株式)	960,000株	607,872,000	303,936,000

(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連してS M B C日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	S M B C日興証券株式会社
割当株数	960,000株
払込金額	607,872,000円

< 中略 >

- 4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。

(注)5の全文削除

(2)【募集の条件】

(訂正前)

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
未定 (注)1	未定 (注)1	100株	平成26年1月21日(火) (注)2	該当事項はありません	平成26年1月22日(水) (注)2

(注)1 発行価格及び資本組入額については、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

2 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、一般募集における申込期間の繰り上げに応じて繰り上げることがあります。申込期間が最も繰り上がった場合は「平成26年1月15日(水)」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「平成26年1月16日(木)」となりますのでご注意ください。

3 全株式をS M B C日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

4 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

5 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払込むものとしします。

(訂正後)

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
633.2	316.6	100株	平成26年1月15日(水)	該当事項はありません	平成26年1月16日(木)

(注)1 全株式をS M B C日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

2 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払込むものとしします。

(注)1、2の全文削除及び3、4、5の番号変更

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
812,591,000	6,245,000	806,346,000

- (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
- 2 前記「1 新規発行株式」(注) 2に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われな
い場合、上記金額は、変更されることとなります。
- 3 払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成25年11月22日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普
通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
607,872,000	6,245,000	601,627,000

- (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
- 2 前記「1 新規発行株式」(注) 2に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われな
い場合、上記金額は、変更されることとなります。

(注) 3の全文削除

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限806,346,000円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額5,411,205,000円と合わせて、手取概算額合計上限6,217,551,000円について、平成25年11月20日公表の中期経営計画の設備投資計画に基づき、当社の子会社であるMeiko Electronics Vietnam Co., Ltd.、名幸電子(武漢)有限公司及び名幸電子(広州南沙)有限公司への投融資資金及び国内工場への設備投資資金に充当する予定であります。具体的には、平成26年3月期に1,300,000,000円、平成27年3月期に2,500,000,000円をベトナム工場におけるビルドアップ基板(注1)等向けの生産設備の増設、フレキシブル基板(注2)向けの生産設備の新設及び建屋付帯設備改修のための設備投資資金に、平成27年3月末までに1,000,000,000円を中国武漢工場におけるビルドアップ基板向けの生産設備の増設及び生産合理化のための設備投資資金に、平成27年3月末までに1,000,000,000円を中国広州工場における品質向上及び生産合理化のための設備投資資金に充当し、残額については、平成27年3月末までに国内工場における新技術及び新製品の導入のための設備投資資金に充当する予定であります。また、具体的な充当時期までは、上記手取金は安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

<後略>

(訂正後)

上記差引手取概算額上限601,627,000円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額4,037,876,000円と合わせて、手取概算額合計上限4,639,503,000円について、平成25年11月20日公表の中期経営計画の設備投資計画に基づき、当社の子会社であるMeiko Electronics Vietnam Co., Ltd.、名幸電子(武漢)有限公司及び名幸電子(広州南沙)有限公司への投融資資金及び国内工場への設備投資資金に充当する予定であります。具体的には、平成26年3月期に1,300,000,000円、平成27年3月期に1,500,000,000円をベトナム工場におけるビルドアップ基板(注1)等向けの生産設備の増設、フレキシブル基板(注2)向けの生産設備の新設及び建屋付帯設備改修のための設備投資資金に、平成27年3月末までに800,000,000円を中国武漢工場におけるビルドアップ基板向けの生産設備の増設及び生産合理化のための設備投資資金に、平成27年3月末までに800,000,000円を中国広州工場における品質向上及び生産合理化のための設備投資資金に充当し、残額については、平成27年3月末までに国内工場における新技術及び新製品の導入のための設備投資資金に充当する予定であります。また、具体的な充当時期までは、上記手取金は安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

<後略>